#### 超精密加工(旋削加工)における高精度回転治具の製作

#### 中央試験所 高野 朋幸



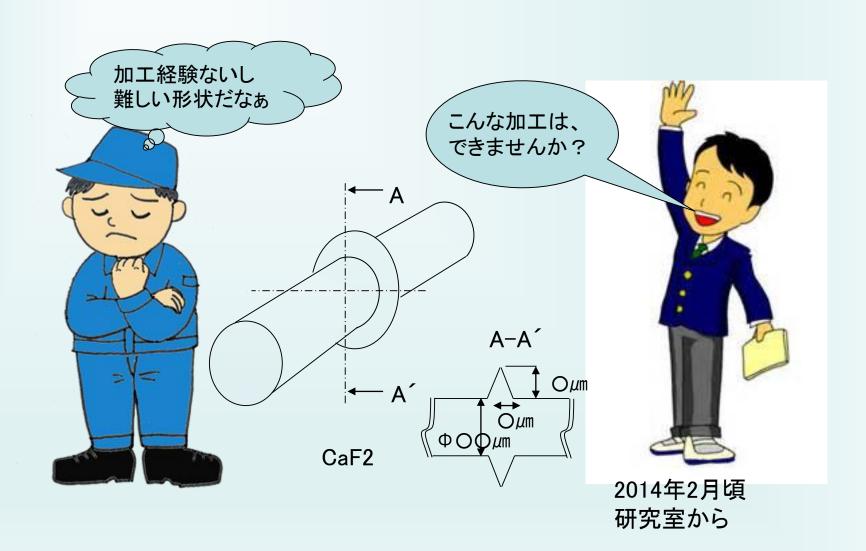
# 発表の流れ



- 1. 背景
- 2. 目的
- 3. 内容
- 4. 結果
- 5. まとめ
- 6. その他

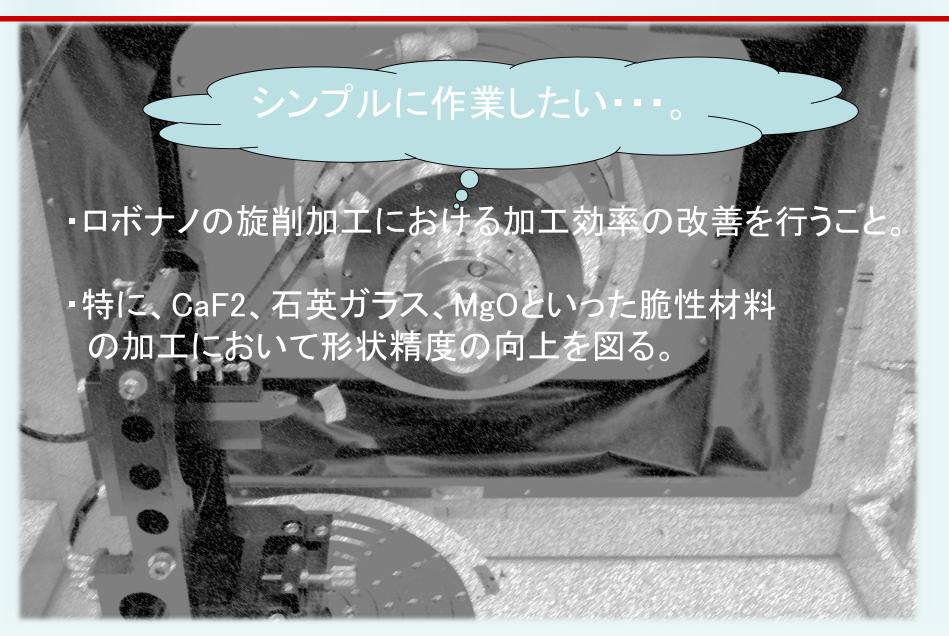
## 1. 背景





#### 2. 目的

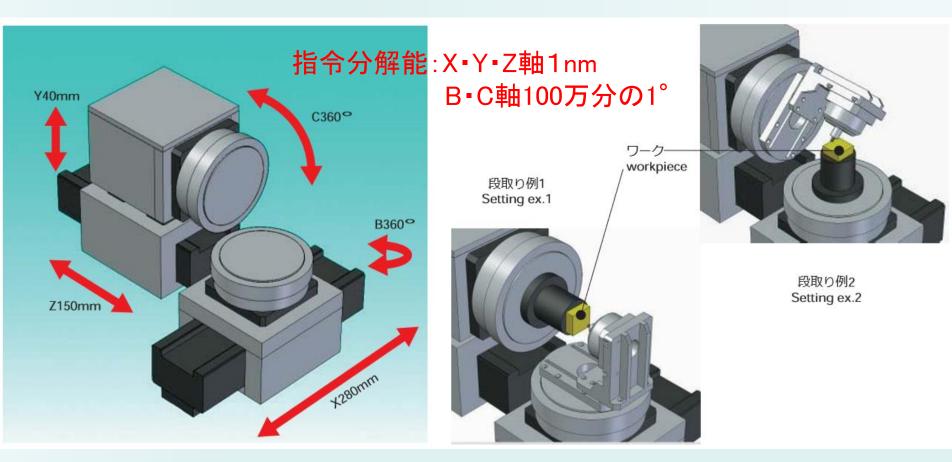




#### 装置のおさらい



## 超精密ナノ加工装置



※図はメーカーカタログによる (FANUC\_Robonao\_α-OiB )

## 3. 内容



- ・従来の旋削加工において、準備に時間がかかりワーク取付後の芯振れ精度が上手くいっても30μmであったため、内・外径切削時の荒加工(ワークの芯出しまで)に切り込む深さは、約50μmの加工が必要であった。改善として、高精度のワーク取付治具(芯振れ精度5μm)を選定し口ボナノに組み込むための取付治具の設計と製作を行い、準備と加工時間の短縮を図った。
- ・治具製作には、マニファクチュアリングセンターの工作機械を使用した。 実際に、治具をロボナノに取付けて回転させダイヤルゲージによる測定 を行った。その後、脆性材料(CaF2)の旋削加工を行った。

#### 従来の方法

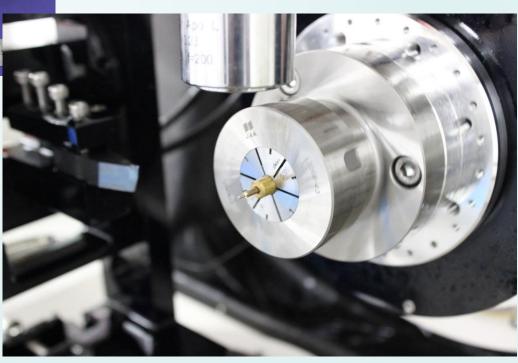




# 製作した治具&セッテイング







### 4. 結果



- ①治具設計には、装置(ロボナノ)図およびG1チャックの寸法から取付け位置を確認して、はめ合い寸法精度を確保したCAD図を作成した。
- ②製作した治具により芯出し調整も容易で高精度の $\pm 1 \mu m$ 以内になったこともあって、設計値(芯ブレ精度 $5 \mu m$ )よりも超高精度(芯ブレ精度 $3 \mu m$ )の治具製作が可能となった。
- ③脆性材料(CaF2)の旋削加工実績として加工効率の向上(荒加工時間の70%~80%短縮)と安定した形状精度(切削時の材料端部の破損なし)の確保が可能となった。



## まとめ



- 加工準備の段階で誰でも芯出し作業が±5μm以内をねらえるようになった。
- 荒取り加工時間の大幅な短縮になった。
- ・ 旋削加工以外の加工方法(フライカット)でも芯出し用治具として利用 可能になった。

## 謝辞



- ■平成27年度技術研修委員会の皆さま。
- •製作にあたりご協力頂いたマニファクチュアリングセンターの皆さま。